

中国半导体行业协会

关于启动2023“创芯中国”集成电路创新 挑战赛的通知

各有关单位：

为贯彻落实国家集成电路产业发展战略部署，进一步引领和驱动我国集成电路产业创新，推动整机与芯片企业联动发展，加强产业协同，营造行业创新氛围，培育产教融合生态，发掘优秀技术人才和创新团队，赋能行业可持续发展，提升我国集成电路产业发展核心竞争力。中国半导体行业协会将启动2023“创芯中国”集成电路创新挑战赛的举办工作，现将大赛有关事项通知如下：

一、大赛宗旨

大赛旨在促进我国集成电路产业发展，以助推自主创新为目标，激发广大高校和企事业单位的自主创新潜力，汇聚并选拔集成电路创新成果，充分发挥创新价值，加快落地应用进程，加速构建我国集成电路产业协同发展的良好生态。同时，推动产业链与创新链深度融合，促进优秀人才的发现和培育，助力我国集成电路产业高质量发展。

二、组织架构

主办单位：中国半导体行业协会

承办单位：北京赛迪网信息技术有限公司

支持单位：集成电路产教融合发展联盟

三、大赛方向

本次大赛以产业需求为导向，聚焦芯机联动领域关键软硬件及应用，结合行业发展难点热点问题、关键技术及创新产品等方面进行赛道设置，参赛队伍可针对不同行业领域的应用场景开展电子电路、软硬件产品及芯片应用等相关创新设计，最终作品呈现可以是应用产品、解决方案或商业计划书。同时，大赛以行业真实场景进行命题，设置技术技能赛道，挖掘并选拔行业高水平技术技能人才。

四、参赛对象及规则

（一）参赛对象

大赛设置应用创新、开源生态、创业孵化等相关产业赛道，参赛对象分为企业组和创客组两个组别。企业组为国内外集成电路产业链上下游相关产品研发及应用服务开发的企业、科研院所等机构；创客组为团队（包括尚未注册成立企业的创客团队及全日制普通高等学校高职、本科及以上在籍学生）或注册成立不满一年的中小微企业。

大赛设置技术技能赛道，参赛对象分为职工组（含院校教师）和学生组两个组别。职工组为具有相关职业工作经历的企业在职人员，从事相关专业工作的高等院校、职业院校（含技工院校）在职人员。学生组为高等院校、职业院校相关专业全日制在籍学生。

（二）报名说明

1. 符合报名条件的人员均可报名参赛；
2. 鼓励高校参赛队伍跨学科、跨专业、跨年级组队；
3. 大赛以团体赛为主，学生组及创客组中的高校参赛队伍须配有1名指导教师；
4. 报名表须有参赛队伍所在单位的盖章；
5. 大赛为公益性赛事，全程不收取任何参赛费用。

（三）比赛要求

1. 比赛作品不得违反国家相关法律法规，不得有侵犯第三方著作权或其它知识产权等侵权行为，由此引发的一切责任均由参赛者承担；
2. 参赛作品必须为原创作品，一经发现抄袭或冒名顶替等行为，将取消本次比赛资格及成绩；
3. 大赛赛道说明、大赛规程、技术概要、评分标准等具体要求详见大赛官网(www.icchuangxin.org.cn)。

五、大赛安排

（一）赛题征集：2023年2月-5月，大赛组委会面向行业企业、科研院所等相关机构开展赛题原型征集工作；

（二）报名阶段：2023年5月-7月，各参赛队伍通过大赛官方网站在线报名并提交作品（技术技能赛道报名及比赛形式另行通知），组委会对参赛项目进行初评；

（三）分赛区决赛时间：2023年7月-9月；

（四）全国总决赛及颁奖典礼时间：拟定于2023年9-10月（具体时间、地点待定）；

（五）未尽事宜由大赛组委会负责最终解释。

六、大赛奖项设置

本届大赛分为初赛、分赛区决赛与总决赛三个阶段（技术技能赛道另行通知）。

（一）初赛及分赛区决赛

初赛将根据参赛提交作品和材料的完整性、规范性和逻辑结构等方面进行初评。经初赛及分赛区决赛评选后,选出晋级总决赛队伍。

（二）总决赛奖励办法

晋级总决赛的队伍,根据总决赛期间的成绩评选出一等奖、二等奖、三等奖等奖项,各奖项获奖队伍可获得相应的奖金或奖品,所有获奖队伍均可获得相应级别证书。另设有突出贡献单位奖、优秀组织单位奖、优秀指导教师奖、优秀裁判员奖、优秀工作者等奖项。

七、大赛监督

为保证大赛公平、公正进行,及时解决大赛组织过程中产生的异议和申诉,有效地监督大赛有序进行,规范赛项管理工作,大赛组委会特设置赛事监督机制,并对提出异议的个人和单位严格保密。

八、其他事项

关于大赛详细内容和进展情况,将在官网上进行更新,请及时关注。

九、大赛组委会联系方式:

联系人:张靖、侯承君

联系电话:010-88558933/8928

电子邮箱:icchuangxin@staff.ccidnet.com

联系地址:北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦

附件:

1. 参赛报名信息表
2. 赛题原型反馈表
3. 评审表

